

证券代码：688403  
转债代码：118049

证券简称：汇成股份  
转债简称：汇成转债

公告编号：2026-009

## 合肥新汇成微电子股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了 2025 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	114,252.79	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	105,958.26
	利息收入净额	B2	68.86
本期发生额	项目投入	C1	6,371.82
	利息收入净额	C2	40.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	112,330.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	109.51
应结余募集资金	E=A-D1+D2	2,032.22	
实际结余募集资金	F	2,032.22	
差异	G=E-F	0.00	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司扬州分行营业部	9550880246966300186		已销户
中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	8112301013201026778	20,322,211.26	
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	514902669010002		已销户
浙商银行股份有限公司合肥分行营业部	3610000010120100588108		已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100460563		已销户
中国银行股份有限公司扬州邗江支行	520980997944		已销户
招商银行股份有限公司扬州邗江支行	514902342810000		已销户
	合计	20,322,211.26	

注：公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理及利息收入 111.74 万元（其中 2025 年度现金管理及利息收入 41.91 万元），已扣除手续费 2.23 万元（其中 2025 年度手续费 1.27 万元），现金管理及利息收入累计净额 109.51 万元（其中 2025 年度现金管理及利息收入净额 40.65 万元）。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	购买日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07330 期	5,000.00	2024/12/12	2025/1/11	8.84	是	0.00
合计		5,000.00			8.84		0.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 114,252.79 万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额 114,870.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件 1。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金 30,000.00 万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供 20,000.00 万元人民币借款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款 20,000.00 万元。

(十) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,汇成股份公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了汇成股份公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查,保荐机构认为,公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				114,252.79		本年度投入募集资金总额				6,371.82		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				112,330.08		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,158.04	33,044.68	-1,955.32	94.41	2026 年 6 月	456.72	不适用	否
12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,213.77	50,028.58	28.58	100.06	2026 年 6 月	1,100.35	不适用	否
补充流动资金	否	29,870.00	29,252.79	29,252.79		29,256.81	4.02	100.01		不适用	不适用	否
合计	—	114,870.00	114,252.79	114,252.79	6,371.82	112,330.08	-1,922.71	—	—	1,557.07	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（九）之说明

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成为实施主体，是本公司及江苏汇成利用现有厂区，在现有技术工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，本公司及江苏汇成 12 吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

注 4：上表中合计值尾差系四舍五入导致。